

2013年度精密工学会春季大会 ランチョンセミナーのお知らせ

2013年度精密工学会春季大会にご参加いただいている企業とのランチョンセミナーを下記要領で開催いたします。最新の機器・ソフト等、研究開発に役立つ情報を各社より直接ご提供いただける機会となっておりますので、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

尚、各セミナー先着50名様には、お弁当をご用意しております。当日整理券を配布いたしますので、下記配布場所にて事前にお受け取りください。(整理券なしでセミナーのみ参加も可能です)

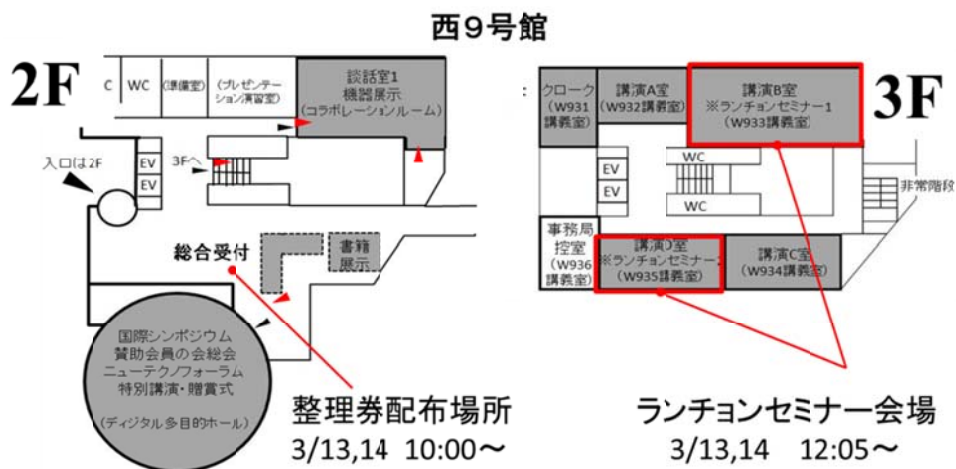
日 時：3月13日(水)、14日(木) 12:05~13:00

場 所：西9号館 3階 B, D室

整理券(無料)配布場所・日時：

西9号館2階 総合受付前 両日とも 10:00~ 各セミナー先着50名様分
(当日分の整理券のみ配布いたします)

	ランチョンセミナー1 (13日)	ランチョンセミナー2 (13日)
3月13日(水)	B室 (司会 東工大 進士)	D室 (司会 東工大 吉岡)
12:05~12:20	計測エンジニアリングシステム(株)	キヤノンマーケティングジャパン(株)
12:25~12:40	ソリッドワークス・ジャパン(株)	レーザーテック(株)
12:45~13:00		三鷹光器(株)
	ランチョンセミナー1 (14日)	ランチョンセミナー2 (14日)
3月14日(木)	B室 (司会 東工大 進士)	D室 (司会 東工大 松村)
12:05~12:20	Optiworks(株)	(株)ピーマックジャパン
12:25~12:40	(株)スギノマシン	(株)マグネスケール
12:45~13:00	サイバーレーザー (株)	



※ランチョンセミナー整理券は、各会場でお弁当・お茶とお引き換えください。整理券の再発行はいたしませんのでご了承ください。

※整理券は、各セミナー開始後10分経過しますと無効になります。ご注意ください。

※セミナーのみのご参加(お弁当なし)も可能です。その場合は直接セミナー会場にお越しください。